



本社：〒160-8366

東京都新宿区西新宿 6 丁目 24 番 1 号
西新宿三井ビルディング

報告書番号：PCN#20120727001B

2012 年 9 月 13 日

お客様各位

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社
営業・技術本部 カスタマドキュメント
マネージャ 牧 達郎 (牧)

HPA/PWR SOT23 (DBV) パッケージ 一部製品 Cu(銅)ワイヤ/リードフレーム追加のご案内

(既報 144 製品からの対象除外 4 製品の連絡)

(第二版 PCN20120727001A 2012 年 8 月 14 日発行, 初版 PCN20120727001 2012 年 8 月 1 日発行)

拝啓 貴社益々ご清栄の事とお喜び申し上げます。平素は弊社製品のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。さて、標題の件につきましてご連絡させていただきます。ご査収の程、宜しくお願い申し上げます。

今回のお知らせは、変更実施についての追加連絡になります。変更の詳細は、次頁以降をご参照下さい。

お客様におかれましては、本通知発行日後、**30 日**以内に通知確認のご連絡をお願いいたします。また、30 日以内にご連絡が無い場合には、本変更をご承認いただけたとものと判断させていただきます。変更品評価用サンプルもしくは追加データご入用の場合には、本通知発行日後 30 日以内にご依頼をお願いいたします。

変更品の出荷につきましては、お客様との早期変更実施の個別契約を締結している場合を除いては、本通知発行日より **90 日**以降に予定いたしております。この通知期間は、弊社品質標準に基づいております。

本通知は、いかなる製品の製造終了に関する状況を変更するものではありません。既に製造終了の連絡をさせていただいている場合には、本通知によって、既通知の最終受注日及び最終出荷日が延長されることはありません。

本通知は、通知日前 24 ヶ月以内に本変更対象製品をご購入いただいたお客様に連絡させていただいております。

尚、変更時期につきましては、在庫状況により異なりますので、担当営業にお問い合わせ下さい。また、ご不明な点、ご質問等がございましたら、担当営業或いは pcn_tij@list.ti.com にお問い合わせ下さい。

以上

変更概要

通知タイプ	☐ Initial notice (Plan)	☒ Final notice
変更概要	Design/Specification	☐ Design ☐ Electrical ☐ Mechanical
	Wafer Fab	☐ Site ☐ Process ☐ Material
	Wafer Bump	☐ Site ☐ Process ☐ Material
	☒ Assembly	☐ Site ☒ Process ☒ Material
	Test	☐ Site ☐ Process
	Others	☐ Packing/Shipping/Labeling ☐ -
変更内容	下記変更について既報 144 製品からの対象除外 4 製品の連絡になります。 HPA/PWR SOT23 (DBV) パッケージ一部製品 Cu (銅) ワイヤ/リードフレーム追加 現行 : Au (金) 線, NiPdAu 表面処理 変更後 : Au (金) 線, NiPdAu 表面処理, Cu (銅) 線, Matte-Sn 表面処理	
対象製品	対象製品リスト参照	
変更時期	11 月中旬の出荷より予定しています。	
品質認定試験	☒ 計画	☐ 終了
製品表示	☐ 変更無し	☒ 変更あり
備考	—	

変更内容

内容：今回のお知らせは、下記変更について既報144製品からの対象除外4製品の連絡になります。弊社 HPA (ハイパフォーマンスアナログ) /PWR (パワーマネジメント) SOT23 (DBV) パッケージ 一部製品について、現行 Au (金) 線ボンディングワイヤ/NiPdAu表面処理リードフレームを使用して製造していますが、機械/電気的特性の向上, 同種製品の組立技術推移対応及び供給能力/部材調達利便性向上の為に、これに加えて、Cu (銅) 線ボンディングワイヤ/Matte-Sn表面処理リードフレームを追加します。その他の部材変更については、下記を参照ください。組立サイトの変更はありません。尚、今回の変更で、製品についての互換性(寸法/公差), 外観, 動作特性, 品質, 信頼性への影響はありません。

変更内容

ボンディングワイヤ

現行

Au (金) 線

変更後

Au (金) 線

Cu (銅) 線

リードフレーム表面処理

NiPdAu

NiPdAu

Matte-Sn

	現行	追加認定
ボンディングワイヤ部材	Au	Cu
モールド樹脂 部材番号	R-13	R-17
リードフレーム端子表面処理	NiPdAu	Matte Sn

理由：機械/電気的特性の向上, 同種製品の組立技術推移対応及び供給能力/部材調達利便性向上の為

詳細：

本変更実施以降、対象製品の鉛フリー対応製品は**単一製品名**に統一されます。

例えば、**TMP125AIDBVT** の製品名で Matte-Sn もしくは NiPdAu 表面処理の製品が出荷されることになります。

NiPdAu 表面処理製品を指定する場合は、例えば、**TMP125AIDBVTG4** のように、末尾 “G4” 付製品名で発注することが可能になります。

対象製品リスト

対象製品名				
□: 既報対象品 取消線: 対象除外品				
HPA00027DBVR	TPS2051CDBVR	TPS73025DBVT	TPS73213DBVR	TPS73633DBVT
HPA00028DBVR	TPS2051CDBVT	TPS730285DBVR	TPS73213DBVT	TPS79101DBVR
HPA00029DBVR	TPS2065CDBVR	TPS730285DBVT	TPS73215DBVR	TPS79101DBVT
HPA00104DBVR	TPS2065CDBVT	TPS73028DBVR	TPS73215DBVT	TPS79118DBVR
HPA00212DBVR	TPS2065DBVR	TPS73028DBVT	TPS73218DBVR	TPS79118DBVT
HPA00237DBVR	TPS2065DBVT	TPS73030DBVR	TPS73218DBVT	TPS79133DBVR
HPA00287DBVR	TPS2550DBVR	TPS73030DBVT	TPS73219DBVR	TPS79133DBVT
HPA00357DBVR	TPS2550DBVT	TPS73033DBVR	TPS73219DBVT	TPS79147DBVR
HPA00408DBVR	TPS2551DBVR	TPS73033DBVT	TPS73225DBVR	TPS79147DBVT
HPA00427DBVR	TPS2551DBVT	TPS73101DBVR	TPS73225DBVT	TPS79201DBVR
HPA00444A1DBVT	TPS2552DBVR	TPS73101DBVT	TPS73230DBVR	TPS79201DBVT
HPA00450DBVR	TPS2552DBVR-1	TPS731125DBVR	TPS73230DBVT	TPS79225DBVR
HPA00457DBVR	TPS2552DBVT	TPS731125DBVT	TPS73233DBVR	TPS79225DBVT
HPA00658DBVR	TPS2552DBVT-1	TPS73115DBVR	TPS73233DBVT	TPS79228DBVR
HPA00660DBVR	TPS2553DBVR	TPS73115DBVT	TPS73250DBVR	TPS79228DBVT
HPA00672DBVR	TPS2553DBVR-1	TPS73118DBVR	TPS73250DBVT	TPS79230DBVR
HPA00709DBVR-1	TPS2553DBVT	TPS73118DBVT	TPS73601DBVR	TPS79230DBVT
HPA00714DBVR	TPS2553DBVT-1	TPS73125DBVR	TPS73601DBVT	TPS79301DBVR
HPA00734DBVR	TPS61040DBVR	TPS73125DBVT	TPS73615DBVR	TPS79301DBVT
HPA01085DBVR	TPS61041DBVR	TPS73130DBVR	TPS73615DBVT	TPS79318DBVR
HPA01085DBVR	TPS72301DBVR	TPS73130DBVT	TPS73618DBVR	TPS79318DBVT
SN6501DBVR	TPS72301DBVT	TPS73131DBVR	TPS73618DBVT	TPS79325DBVR
TMP125A1DBVT	TPS72325DBVR	TPS73131DBVT	TPS73625DBVR	TPS793285DBVR
TMP300A1DBVR	TPS72325DBVT	TPS73133DBVR	TPS73625DBVT	TPS793285DBVT
TMP300A1DBVT	TPS73001DBVR	TPS73133DBVT	TPS73630DBVR	TPS79328DBVR
TPS2041BDBVR	TPS73001DBVT	TPS73150DBVR	TPS73630DBVT	TPS79330DBVR
TPS2041BDBVT	TPS73018DBVR	TPS73150DBVT	TPS73632DBVR	TPS79333DBVR
TPS2051BDBVR	TPS73018DBVT	TPS73201DBVR	TPS73632DBVT	TPS793475DBVR
TPS2051BDBVT	TPS73025DBVR	TPS73201DBVT	TPS73633DBVR	

製品表示

今回の変更に伴い、出荷ラベルに記載の ECAT コードが下記のようになります。

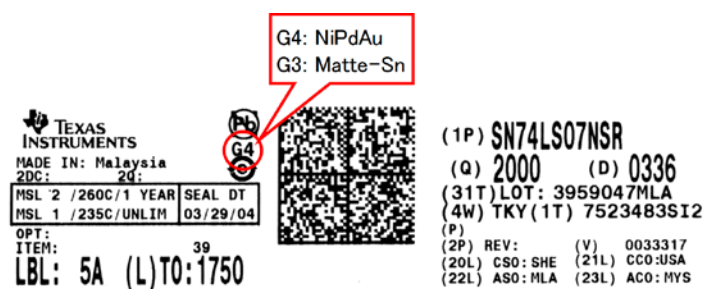


図1 出荷ラベルの例

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社

信頼性試験

信頼性試験計画

信頼性試験期間	開始	2012 年 9 月	終了	2013 年 2 月
信頼性試験 - 試料構成詳細				
Qual Device:	TPS2051BDBVR	-	-	
Assembly Site:	NFME	Package/Code/Pins:	SOT-23/DBV/5	
Mount Compound:	A-03	Mold Compound:	R-17	
Bond Wire:	1.3 Mil Dia., Cu	Lead frame (Finish, Base):	Matte Sn, Cu	
MSL:	JEDEC L-1/260C	-	-	
信頼性試験計画				
Reliability Test	Condition / Duration		Sample Size	
Electrical Characterization	-		30	
**T/C	-65C/150C, 500 Cyc		77	
Manufacturability (Assembly)	per mfg. Site specification		per spec	
Moisture Sensitivity	JEDEC L-1/260C		12	
Notes: ** Preconditioning sequence: JEDEC L-1/260C.				

信頼性試験計画

信頼性試験期間	開始	2012 年 9 月	終了	2013 年 2 月
信頼性試験 - 試料構成詳細				
Qual Device:	TPS2051CDBVR	-	-	
Assembly Site:	NFME	Package/Code/Pins:	SOT-23/DBV/5	
Mount Compound:	A-03	Mold Compound:	R-17	
Bond Wire:	1.3Mil Dia., Cu	Lead frame (Finish, Base):	Matte Sn, Cu	
MSL:	JEDEC L-2/260C	-	-	
信頼性試験計画				
Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size		
		Lot1	Lot2	Lot3
** High Temp Operating Life	125C, 500, 1000 Hrs	77	77	77
Electrical Characterization	-	per spec	per spec	per spec
**High Temp. Storage Bake	150C, 500, 1000 Hrs	77	77	77
**Biased HAST	130C/85%RH, 96 Hrs	78	78	78
**Unbiased HAST	130C/85%RH, 96 Hrs	77	77	77
**T/C	-65C/150C, 500 Cyc	77	77	77
Manufacturability (Assembly)	per mfg. Site specification	per spec	per spec	per spec
Moisture Sensitivity	JEDEC L-2/260C	12	12	12
Notes: ** Preconditioning sequence: JEDEC L-2/260C.				

信頼性試験計画

信頼性試験期間	開始	2012 年 9 月	終了	2013 年 2 月
信頼性試験 - 試料構成詳細				
Qual Device:	TPS2553DBVR	-	-	
Assembly Site:	NFME	Package/Code/Pins:	SOT-23/DBV/6	
Mount Compound:	A-03	Mold Compound:	R-17	
Bond Wire:	2.0Mil Dia., Cu	Lead frame (Finish, Base):	Matte Sn, Cu	
MSL:	JEDEC L-1/260C	-	-	
信頼性試験計画				
Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size		
		Lot1	Lot2	Lot3
** High Temp Operating Life	125C, 500, 1000 Hrs	77	77	77
Electrical Characterization	-	per spec	per spec	per spec
**High Temp. Storage Bake	150C, 500, 1000 Hrs	77	77	77
**Unbiased HAST	130C/85%RH, 96 Hrs	77	77	77
**T/C	-65C/150C, 500 Cyc	77	77	77
Manufacturability (Assembly)	per mfg. Site specification	per spec	per spec	per spec
Moisture Sensitivity	JEDEC L-1/260C	12	12	12
Notes: ** Preconditioning sequence: JEDEC L-1/260C.				

信頼性試験計画				
信頼性試験期間	開始	2012 年 9 月	終了	2013 年 2 月
信頼性試験 - 試料構成詳細				
Qual Device:	TPS61041DBVR	-	-	
Assembly Site:	NFME	Package/Code/Pins:	SOT-23/DBV/5	
Mount Compound:	A-03	Mold Compound:	R-17	
Bond Wire:	1.3Mil Dia., Cu	Lead frame (Finish, Base):	Matte Sn, Cu	
MSL:	JEDEC L-1/260C	-	-	
信頼性試験計画				
Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size		
		Lot1	Lot2	Lot3
Electrical Characterization	-	per spec	per spec	per spec
**High Temp. Storage Bake	150C, 500, 1000 Hrs	77	77	77
**Biased HAST	130C/85%RH, 96 Hrs	78	78	78
**Unbiased HAST	130C/85%RH, 96 Hrs	77	77	77
**T/C	-65C/150C, 500 Cyc	77	77	77
Manufacturability (Assembly)	per mfg. Site specification	per spec	per spec	per spec
Moisture Sensitivity	JEDEC L-1/260C	12	12	12
Notes: ** Preconditioning sequence: JEDEC L-1/260C.				